

2024年12月吉日

お客様各位

『第26回半導体・センサパッケージング展』出展のご案内

拝啓 御社益々御清栄の事とお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊社は2025年1月に開催されますネプコンジャパン2025に出展する運びとなりました。
今回、各用途に合わせたシンターペーストをはじめ、各種はんだ製品を出展いたします。
皆様方には御来場いただきまして、是非ともニホンハンダの製品をご高覧賜りたくご案内申し上げます。
※ご来場には事前登録が必要となります。お手数ですが下記URLよりご登録をお願いいたします。

来場登録はコチラ >

<https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1232358990639683-H02>

《展示会概要》

出展展示会：第26回 半導体・センサパッケージング展

日時：2024年1月22日（水）～24日（金）10:00～17:00

場所：東京ビッグサイト 東東場7ホール（交通アクセス：<https://www.bigsight.jp/visitor/access/>）

小間番号：E65-28

《主な出展製品》

◇パワーデバイス向け

【銅接合可能な無加圧シンターペースト】

☆新製品☆ 低温短時間化可能 (MAX534)

☆新製品☆ 微小チップ対応 (MAX5342)

・無加圧でありながら加圧並みの接合強度を実現 (MAX4022)

【ソルダペースト】

・高信頼性合金を使用した、ボイド低減タイプ (PF830-150(A1))

・高速塗布対応、ジェットディスペンサー用 (207S(ETR))

◇半導体パッケージ向け

【エポキシ系導電性接着剤】

・90°Cの低温接合、加熱温度を上げると時間短縮可能 (ECA シリーズ)

【ソルダペースト】

・ぬれ性・ボイド特性に優れ、微小～大面積まで対応可能な汎用型 (153)

・塗布径 90μm が可能な微小塗布対応品 (5091)

◇開発品、参考出品

・Type6・7に対応した、Sn-Bi系低融点ソルダペースト

- ・ 高熱伝導と低弾性を実現した導電性接着剤
- ・ 無加圧銅シンターペースト

《新製品・技術セミナー》

この度、弊社では「シンターペースト」に関する技術セミナーを開催する運びとなりました。
詳細は下記の通りとなりますので、皆様のご参加を心よりお待ちしております。

【セミナー詳細】

- ・ テーマ：「銅基板へ接合可能な無加圧高強度シンターペーストのご紹介」
- ・ 場所：新製品・新技術セミナー会場 2
- ・ 日時：2025年1月24日(金) 13:00~13:30

※受講無料・事前申込不要のセミナーとなります。

ただ、聴講者が席数を超えた場合は、ご聴講いただけない可能性もございます。

社員一同、皆様のご来場を心よりお待ちしております。

敬具